



INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE

**Semiconductor devices –
Part 1: General**

**Dispositifs à semiconducteurs –
Partie 1: Généralités**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

PRICE CODE
CODE PRIX



ICS 31.080

ISBN 978-2-88910-273-0

CONTENTS

FOREWORD.....	4
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	6
3.1 Device structure	6
3.2 Elements and circuits	7
3.3 Thermal characteristics	8
3.4 Noise	9
3.5 Conversion loss.....	9
3.6 Stability of characteristics.....	10
4 Letter symbols.....	10
4.1 General.....	10
4.2 Letter symbols for currents, voltages and powers	11
4.3 Letter symbols for signal ratios expressed in dB.....	13
4.4 Letter symbols for other electrical properties	14
4.5 Letter symbols for other properties	15
4.6 Presentation of limit values	17
5 Essential ratings and characteristics.....	18
5.1 General.....	18
5.2 Relationship between conditions of use, ratings and characteristics	18
5.3 Standard format for the presentation of published data.....	19
5.4 Type identification	19
5.5 Terminal and polarity identification	19
5.6 Electrical ratings and characteristics	20
5.7 Cooling conditions.....	20
5.8 Recommended temperatures.....	21
5.9 Recommended voltages and currents.....	21
5.10 Mechanical ratings (limiting values).....	21
5.11 Mechanical characteristics	22
5.12 Multiple devices having a common encapsulation.....	22
6 Measuring methods	23
6.1 General.....	23
6.2 Alternative methods of measurement.....	23
6.3 Measurement accuracy	24
6.4 Protection of devices and measuring equipment.....	24
6.5 Thermal conditions for measuring methods	24
6.6 Accuracy of measuring circuits.....	25
7 Acceptance and reliability of discrete devices.....	27
7.1 General.....	27
7.2 Electrical endurance tests	27
8 Electrostatic-sensitive devices.....	31
8.1 Label and symbol	31
8.2 Test methods for semiconductor devices sensitive to voltage pulses of short duration.....	32
9 Product discontinuance notification	32
9.1 Definitions	32

9.2	General aspects for discontinuation.....	33
9.3	Information for the discontinuance notification.....	33
9.4	Notification	33
9.5	Retention	34
Annex A (informative)	Presentation of IEC 60747 and IEC 60748	35
Annex B (informative)	Clause cross-references from first edition of IEC 60747-1 (1983).....	39
Bibliography.....		44
Figure 1 – Example of the application of the rules to a periodic current.....		11
Figure 2 – Derating curve		28
Figure 3 – Symbol to be used for the electrostatic sensitive devices that require special handling.....		32
Table 1 – Presentation of limit values with the two conventions		18
Table 2 – Failure rate operating conditions		29

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES –

Part 1: General

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60747-1 has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This second edition of IEC 60747-1 cancels and replaces the first edition (1983) and its amendments 1 (1991), 2 (1993) and 3 (1996).

The main changes with respect to the previous edition are listed below.

- a) The terminology which is now given in the IECV (or which was in conflict with the IECV) has been omitted.
- b) There has been a general revision of guidance on essential ratings and characteristics.
- c) The distinction between general and reference methods of measurement has been removed.
- d) A clause on product discontinuation notice has been added.

This bilingual version, published in 2009-11, corresponds to the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47/1841/FDIS	47/1848/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all the parts in the IEC 60747 series, under the general title *Semiconductor devices*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the maintenance result date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of September 2008 have been included in this copy.

SEMICONDUCTOR DEVICES –

Part 1: General

1 Scope

This part of IEC 60747 gives the general requirements applicable to the discrete semiconductor devices and integrated circuits covered by the other parts of IEC 60747 and IEC 60748 (see Annex A).

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60027 (all parts), *Letter symbols to be used in electrical technology*

IEC 60050-521, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 521: Semiconductor devices and integrated circuits*

IEC 60050-702, *International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 702: Oscillations, signals and related devices*

IEC 60068 (all parts), *Environmental testing*

IEC 60191-2, *Mechanical standardization of semiconductor devices – Part 2: Dimensions*

IEC 60747 (all parts), *Semiconductor devices*

IEC 60748 (all parts), *Semiconductor devices – Integrated circuits*

IEC 60749-26, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 26: Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing – Human body model (HBM)*

IEC 61340 (all parts), *Electrostatics*

QC 001002 (all parts), *IEC Quality Assessment Systems for Electronic Components (IECQ) – Rules of procedure*

ISO 9000, *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS.....	48
1 Domaine d'application	50
2 Références normatives.....	50
3 Termes et définitions	50
3.1 Structure du dispositif.....	51
3.2 Eléments et circuits	51
3.3 Caractéristiques thermiques	52
3.4 Bruit.....	53
3.5 Perte de conversion	54
3.6 Stabilité des caractéristiques.....	54
4 Symboles littéraux.....	55
4.1 Généralités.....	55
4.2 Symboles littéraux pour les courants, les tensions et les puissances.....	55
4.3 Symboles littéraux pour les rapports de signaux exprimés en dB.....	58
4.4 Symboles littéraux pour les autres propriétés électriques	58
4.5 Symboles littéraux pour d'autres propriétés.....	60
4.6 Présentation des valeurs limites	61
5 Valeurs limites et caractéristiques essentielles	62
5.1 Généralités.....	62
5.2 Relation entre les conditions d'utilisation, les valeurs limites et les caractéristiques.....	62
5.3 Feuille cadre pour la présentation des données publiées.....	63
5.4 Identification de type	64
5.5 Identification des bornes et de la polarité	64
5.6 Valeurs limites et caractéristiques électriques	64
5.7 Conditions de refroidissement	64
5.8 Températures recommandées	65
5.9 Tensions et courants recommandés	65
5.10 Valeurs limites mécaniques	66
5.11 Caractéristiques mécaniques.....	67
5.12 Dispositifs multiples ayant une encapsulation commune.....	67
6 Méthodes de mesure	68
6.1 Généralités.....	68
6.2 Autres méthodes de mesure.....	68
6.3 Précision des mesures	68
6.4 Protection des dispositifs et de l'appareillage de mesure.....	69
6.5 Conditions thermiques des méthodes de mesure.....	69
6.6 Précision des circuits de mesure	70
7 Réception et fiabilité des dispositifs discrets.....	72
7.1 Généralités.....	72
7.2 Essais d'endurance électriques	72
8 Dispositifs sensibles aux charges électrostatiques	76
8.1 Etiquette et symbole.....	76
8.2 Méthodes d'essai pour les dispositifs à semiconducteurs sensibles à des impulsions de tension de courte durée	77
9 Notification de suppression d'un produit	77

9.1 Définitions	77
9.2 Aspects généraux de la suppression	78
9.3 Informations pour la notification de suppression	78
9.4 Notification	78
9.5 Conservation	79
Annexe A (informative) Présentation de la CEI 60747 et de la CEI 60748	80
Annexe B (informative) Références croisées des articles de la première édition de la CEI 60747-1 (1983)	84
Bibliographie.....	89
Figure 1 – Exemple d’application des règles à un courant périodique	55
Figure 2 – Courbe de réduction.....	73
Figure 3 – Symbole à utiliser pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques nécessitant une manipulation spéciale	77
Tableau 1 – Représentation graphique des valeurs limites dans les deux conventions.....	62
Tableau 2 – Taux de défaillance en fonction des conditions de fonctionnement	74

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 1: Généralités

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de la CEI. La CEI n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60747-1 a été établie par le comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Cette deuxième édition de la CEI 60747-1 annule et remplace la première édition (1983) et ses amendements 1 (1991), 2 (1993) et 3 (1996).

Les principaux changements par rapport à l'édition précédente sont énumérés ci-dessous.

- a) La terminologie figurant actuellement dans le VEI (ou qui était en contradiction avec le VEI) a été omise.
- b) Les lignes directrices relatives aux valeurs limites et caractéristiques essentielles ont fait l'objet d'une révision générale.
- c) La distinction entre méthodes de mesure générales et de référence a été supprimée.
- d) Un article relatif à l'annonce de suppression d'un produit a été ajouté.

La présente version bilingue, publiée en 2009-11, correspond à la version anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 47/1841/FDIS et 47/1848/RVD.

Le rapport de vote 47/1848/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série CEI 60747, présentée sous le titre général *Dispositifs à semiconducteurs*, peut être consultée sur le site web de la CEI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de maintenance indiquée sur le site web de la CEI sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum de septembre 2008 a été inclus dans cette version.

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS –

Partie 1: Généralités

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60747 spécifie les exigences générales applicables aux dispositifs discrets à semiconducteurs et aux circuits intégrés couverts par les autres parties de la CEI 60747 et de la CEI 60748 (voir Annexe A).

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60027 (toutes les parties), *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*

CEI 60050-521, *Vocabulaire électrotechnique international (VEI) – Partie 521: Dispositifs à semiconducteurs et circuits intégrés*

CEI 60050-702, *Vocabulaire électrotechnique international (VEI) – Partie 702: Oscillations, signaux et dispositifs associés*

CEI 60068 (toutes les parties), *Essais d'environnement*

CEI 60191-2, *Normalisation mécanique des dispositifs à semiconducteurs – Partie 2: Dimensions*

CEI 60747 (toutes les parties), *Dispositifs à semiconducteurs*

CEI 60748 (toutes les parties), *Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés*

CEI 60749-26, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 26: Essai de sensibilité aux décharges électrostatiques (DES) – Modèle du corps humain (HBM)*

CEI 61340 (toutes les parties), *Electrostatique*

QC 001002 (toutes les parties), *Système CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) – Règles de procédure* (disponible en anglais seulement)

ISO 9000, *Systèmes de management de la qualité – Principes essentiels et vocabulaire*